

九江德福科技股份有限公司

关于公司签订《高端铜箔合作意向书》的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次签署的《高端铜箔合作意向书》为公司日常经营意向合同，最终采购数量及相关合同条款，以双方正式合同为准，最终的采购金额存在不确定性；
- 2、本次框架合同的签订对公司本年度经营业绩不产生重大影响。预计将对公司 2026 年度经营业绩产生积极影响，具体影响以公司披露的定期报告为准。本事宜对公司业务独立性不构成影响，公司不会因本事宜而对该客户形成依赖；
- 3、公司不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。

一、协议签署概况

近日，九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司九江德福销售有限公司（以下简称“德福销售”）与国内知名头部 CCL 企业（以下简称“该企业”）签署了《高端铜箔合作意向书》（以下简称“协议”或“本协议”），为保障电解铜箔产品供应的长期稳定性，协议约定 2026 年度由德福销售向该企业供应满足最低数量要求的 RTF1-4、HVLP1-4 等高端电子电路铜箔产品，最终采购数量及相关合同条款，以双方正式合同为准。

本协议为公司日常经营合同，公司已经依据内部管理制度的规定履行了相应的审批程序，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《九江德福科技股份有限公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需公司董事会及股东大会审议批准。

二、协议主要内容

- 1、产品类型：高端电子电路铜箔
- 2、协议采购情况：客户向公司采购满足最低数量要求的 RTF1-4、HVLP1-4 等高端电子电路铜箔产品。
- 3、协议生效时间：2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

三、协议对公司的影响

- 1、若协议能顺利履行，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，具体收入确认情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认，相关财务数据的确认以经审计财务报告为准。
- 2、本协议的签订有利于交易双方建立长期稳定的合作关系，有助于进一步提升公司产业链地位、市场影响力及核心竞争力，也对公司未来在全球电子电路铜箔市场的布局和发展具有重要意义，有利于巩固公司在国际市场竞争优势。
- 3、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行协议而对当事人形成依赖。
- 4、公司具备良好的履约能力，人力、技术和产能均能够保证本合同的顺利履行。

四、风险提示

在协议的履行过程中，可能存在外部宏观环境变化、国家有关政策调整或不可抗力等因素的影响，使得该协议在执行过程中具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意风险。

六、其他相关说明

- 1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，及时披露本协议的进展及重大变化情况。
- 2、截至本合同签订日，公司未收到控股股东、持股 5%以上股东及董事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知，如未来发生相关持股变动，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

七、备查文件

- 1、双方签署的《高端铜箔合作意向书》

特此公告

九江德福科技股份有限公司董事会

2026年1月5日